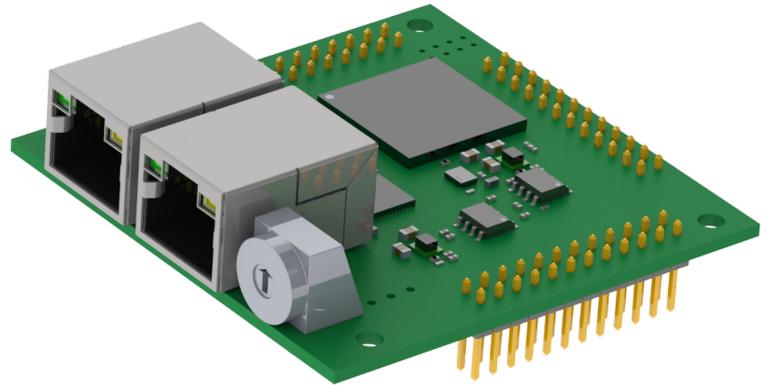


GIN-TTL

Digital-Interface



- ➔ 60 frei konfigurierbare GPIOs
- ➔ Universell, flexibel, kostengünstig
- ➔ Anschlüsse Standard mit Stiftleisten

Facts	
Digitale 3,3V Eingänge und Ausgänge Total	60 I/O
I/O Signaling Standard	LVC MOS
Spannungspegel	3,3 V
Max. Ausgangsstrom pro Ausgang	4 mA
Ausgangsbeschaltung	Tri-State
FPGA	Xilinx Spartan6
Schnittstellen	1 × GinLink Gigabit-Ethernet Feldbus Eingang 1 × GinLink Gigabit-Ethernet Feldbus Ausgang
Abmessungen	mit Stiftleisten 60x60x25 mm (LxBxH) mit Buchsenleisten 60x60x20 mm (LxBxH)
Logikspeisung	3,3VDC ± 10 %
Stromaufnahme	min. 180 / typ. 250 / max. 350 mA

Das GIN-TTL ist ein universell einsetzbares digitales I/O-Modul. Die Karte beinhaltet 60 Eingänge oder Ausgänge mit LVCMOS-Pegel. Das Modul ist als Aufsatz für Printmontage konzipiert. Mit der Standard Firmware stehen 60 frei konfigurierbare GPIOs zur Verfügung. Durch kundenspezifische FPGA-Firmware können zusätzliche Funktionen eingebaut werden; z.B. Interrupt Ein- und Ausgänge. Mit dem GIN-TTL Modul existiert somit eine sehr flexible und kostengünstige Schnittstelle zwischen bestehenden Fremdgeräten und dem GinLink.

Der GinLink Feldbus setzt mit der Übertragungsrate von 1 GBit/s neue Maßstäbe in der Automation. Die hohe Feldbusgeschwindigkeit des GinLinks ermöglicht völlig neue Lösungsansätze in der Steuerungstechnik. Die Datenübertragung erfolgt CPU-unabhängig durch FPGAs. Dies garantiert tiefste Latenzzeiten und höchste Synchronität zwischen Master und Slaves. Der GinLink basiert auf erprobter Gigabit-Ethernet-Technologie. Der Einsatz von Standard Industriekomponenten senkt Kosten und garantiert maximale Verfügbarkeit. Wie bei allen anderen Indel CPU-Boards ist die OPC UA Kommunikation direkt in der Maschinensoftware implementiert. Da OPC UA flexibel und völlig plattformunabhängig ist, gilt es als ideales Kommunikationsprotokoll für die Umsetzung von Industrie 4.0.